

PCN#20150911001
チップコーティング部材変更

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知 **Page 3** 記載の変更実施予定日 (**proposed 1st ship date**) 以降に予定いたしております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20150911001	PCN 日付:	09/14/2015						
表題:	チップコーティング部材変更								
PCN 詳細									
変更内容:									
TI は、下記対象製品の WCSP chip について、下記の通り、代替 チップコーティング部材(die coat material)の認定を連絡します。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Die Coat Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Current</td> <td>BCB (Benzocyclobutene)</td> </tr> <tr> <td>New</td> <td>PI (polyimide)</td> </tr> </tbody> </table>					Die Coat Material	Current	BCB (Benzocyclobutene)	New	PI (polyimide)
	Die Coat Material								
Current	BCB (Benzocyclobutene)								
New	PI (polyimide)								
変更理由:									
供給確保のための生産柔軟性(manufacturing flexibility)増加									
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:									
なし									

注記)

- 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
- 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order/Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Anticipated impact on Material Declaration** (材料宣言に関する懸念事項)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等